

(51) 国際特許分類6  
H01L 21/68

A1

(11) 国際公開番号

WO99/52143

(43) 国際公開日

1999年10月14日(14.10.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/01766

(22) 国際出願日

1999年4月2日(02.04.99)

(30) 優先権データ

特願平10/108579

1998年4月4日(04.04.98)

JP

(81) 指定国 KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

東京エレクトロン株式会社

(TOKYO ELECTRON LIMITED)[JP/JP]

〒107-8481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者 ; および

(75) 発明者 / 出願人 (米国についてのみ)

小沢雅仁(OZAWA, Masahito)[JP/JP]

〒408-0019 山梨県北巨摩郡高根町村山東割1214

Yamanashi, (JP)

成島正樹(NARUSHIMA, Masaki)[JP/JP]

〒406-0853 山梨県東八代郡境川村藤壠412 Yamanashi, (JP)

(74) 代理人

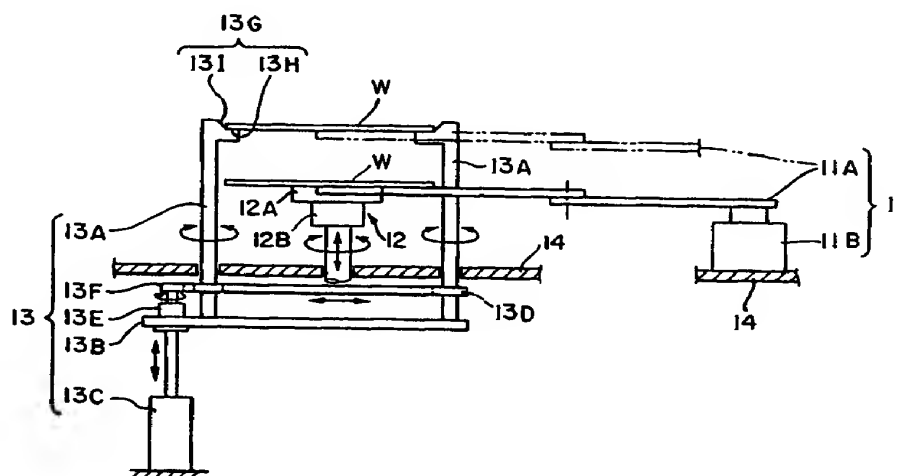
佐藤一雄, 外(SATO, Kazuo et al.)

〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号

富士ビル323号 協和特許法律事務所 Tokyo, (JP)

(54) Title: **ALIGNMENT PROCESSING MECHANISM AND SEMICONDUCTOR PROCESSING DEVICE USING IT**

(54) 発明の名称 アライメント処理機構及びそれを用いた半導体処理装置



## (57) Abstract

An alignment high-speed processing mechanism (10), comprising a transfer mechanism (11) for carrying a body to be treated (W), an alignment mechanism (12) for aligning the body to be treated (W) to be carried by the transfer mechanism (11) in a specified direction, and a buffer mechanism (13) for transferring the body to be treated (W) from the transfer mechanism (11) to the alignment mechanism (12), the buffer mechanism (13) temporarily holding the body to be treated (W) carried by the transfer mechanism (11) and transferring the body to be treated (W) held temporarily to the alignment mechanism (12) according to the conditions of the alignment mechanism (12), whereby the use efficiency of the alignment mechanism (12) is increased, and an increased speed of alignment processing is achieved.